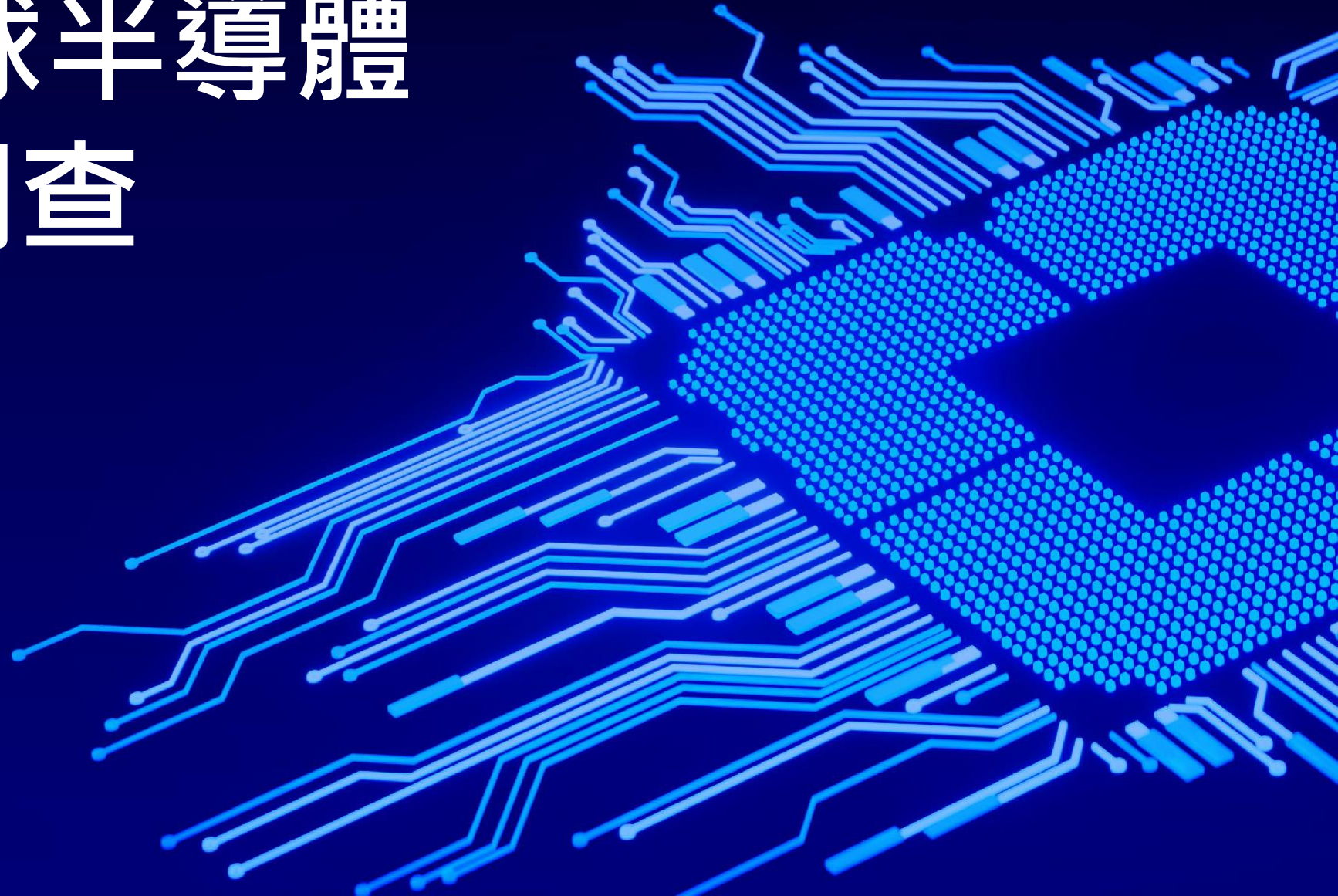




# 2026全球半導體 產業大調查

[kpmg.com/tw/tmt](https://kpmg.com/tw/tmt)

—  
May 2026



# 報告摘要

## 超級循環正驅動半導體產業結構轉變

### AI 首次成為企業最主要的營收成長引擎

73%的產業領導者將AI視為最主要的成長來源，高於去年的67%，並領先雲端運算與資料中心。隨著AI對運算能力需求的提升，記憶體的重要性亦大幅攀升。

目前已有67%的受訪者將記憶體視為首要營收成長機會，數據首次與微處理器的表現相近(66%)。這些轉變顯示，市場正進入由AI全面帶動的新階段，推動半導體技術的堆疊，包含運算、儲存、資料傳輸相關的晶片需求，皆同步呈現成長的趨勢。

### 因應地緣政治壓力與貿易不確定性，供應鏈敏捷性已成為半導體首要策略重點。

45%認為，供應鏈速度的提升與供應鏈的彈性調整策略，已成為最關鍵的優先事項，該項數據首度超越人才發展。企業布局方向已十分明確，主要為分散採購與製造據點、推動規劃流程數位化，並縮短從需求提出到實際回應間的時間。

產業領導者正將AI導入企業內部，以因應日益擴大的人才缺口。

66%的企業計畫運用AI來提升員工生產力，包括強化團隊技能、自動化例行性工作，讓稀缺的工程與營運人才，能專注於更高價值的任務。運用相同的成長動能，使產業在受限的環境中發揮作用。

### 即便風險存在，整體信心正持續上升。

半導體產業信心指數今年為63，高於去年的59，並創下21年來調查中的第三高。多數公司預期將增加資本支出、人力編制以及IT投資。即使企業仍對於地緣政治風險、貿易摩擦與資源限制高度警覺，但這項樂觀預期並非只憑任一季度表現，而是基於持續的需求預測。

儘管AI正持續形塑半導體超級循環，領導者仍然對於供應鏈限制、能源供給可用性，以及地緣政治等影響表示疑慮。為維持企業韌性，應建立高度彈性的商業模式，能隨需求迅速變化調整；



同時透過供應鏈多元化布局，降低單一地緣政治風險，並持續擴大R&D投資，在下一波技術浪潮中保持領先。最後，企業也必須做好人才因應準備，並善用AI強化組織整體影響力。綜合觀察，能夠成功落實這些策略的領導者，將更有機會在未來十年為公司創造更佳優異的成長表現。

# 分辨AI的迷思與現實

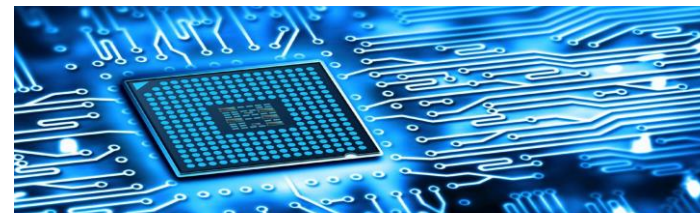
儘管部分投資人擔心，AI 的發展是否是受惠於資金炒作，但多項證據顯示情況並非如此。當前的AI 成長是由實際使用需求所驅動、具備長期可持續性的成長，並伴隨著高額資本投入與承諾。

>**資料中心的容量已滿載**。2025年第二季，資料中心的使用率達到92.4%，創下歷史新高。這一數據顯示，其內部的運算資源正被高度且持續地使用，包括用於人工智慧的GPU在內，並非處於閒置狀態，而是實際投入運作。

>**投資規模廣泛且具全球性**。僅在2025年，該產業即完成超過100筆資料中心交易，其中約610億美元用於建置因應AI使用需求持續攀升所需的運算基礎設施。此投資規模與2024年相似，但相較於2023年的155 億美元以及 2024 年的 288 億美元，仍顯著成長。2019 年以來，相關的累積投資金額（包含併購交易、資產出售與股權投資）美國與加拿大已達1,600億美元、亞太區400億美元、歐洲242億美元。如此龐大的投資規模與地理分布，顯示這並非短期的投機熱潮，而是有結構性意義的產業轉變。同時，數據也反映北美與亞太地區的投資強度持續高於歐洲，這可能與當地較高的能源成本、半導體供應鏈的在地化布局，以及更嚴格的資料主權法規等因素有關。

>**AI正加速向邊緣端擴展**。各類具備資料處理與運算能力的設備製造商—包括智慧型手機、汽車及工業設備，正陸續導入AI運算核心。隨著AI部署加速，同步與雲端AI基礎建設形成加乘效應，市場預期至2029年，AI晶片的全球營收將達到4,385億美元，未來五年的年均複合成長率(CAGR)為25.9%。

>**晶片製造商持續擴大長期投資**。2025年的晶圓製造設備支出增加12%，達1,160億美元，高於前一年所創下的1,040億美元高點。此一成長反映出先進製程邏輯晶片與記憶體製造的投資明顯增加。預測2026年晶圓廠設備支出預計將再成長9%，攀升至1,260億美元，顯示該投資動能並非短期波動，而是具備延續性的多年投資循環。假設AI的採用速度與運算強度持續維持當前節奏，半導體產業領導者將面臨關鍵課題，重新思考這股成長動能將如何促使企業檢視其投資優先順序、供應鏈韌性，以及全球產能配置策略。相關決策將直接奠定企業未來十年的競爭優勢。



## 區域差異

AI 對半導體產業營收的影響具區域差異。調查顯示，美國受訪者對AI的重視程度最高(81%)，反映該國完善的科技生態系統、半導體與AI創新的高度集中。其次為歐洲(70%)與亞太地區(67%)，相較於美國，上述地區視AI為主要營收驅動因素的程度較低。

# 關鍵發現

1



## AI 躍居營收成長的核心驅動力

73%的受訪者認為AI已成為半導體公司的主要營收來源，該數據較去年的67%再度上升。其次為雲端運算、資料中心與網路相關業務，占比為61%，較先前的63%略為下滑。

2



## 記憶體成長機會躍升與微處理器並列

67%的高階主管指出，記憶體解決方案現已成為首要的成長優先項目，較去年的49%大幅提升，並持續縮小與微處理器之間長期存在的差距。

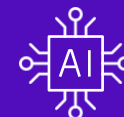
3



## 供應鏈已成為最優先的關注焦點

供應鏈議題過去三年來首度躍升為核心焦點；同時，有45%的受訪者認為，讓供應鏈更具即時回應能力是最重要的優先任務。

4



## AI提升人力效能而非精簡組織

41%的受訪者表示，人才將是未來三年內產業面臨的第二大關鍵挑戰；此外，三分之二的半導體高層認為，AI的角色在於強化與賦能，並非用於縮減人力的工具。

5



## 儘管風險持續浮現，市場樂觀度仍持續升溫

本次調查的信心指數由去年的59上升至63，創下21年來第三高的水準，顯示即使挑戰持續存在，整體仍維持樂觀態度。

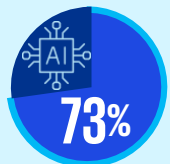


## 關鍵發現 1

# AI 躍居營收成長的核心驅動力

每一個AI的關鍵時刻——無論是於工廠產線上辨識缺陷、撰寫銷售提案，或在車流中執行自動駕駛都始於一個根本問題：系統是否能夠以足夠的速度，將大量資料轉化為具備實際價值的決策？半導體正是實現這種速度的核心所在。它們構成了所有模型背後的運算能力與記憶基礎，負責高速傳輸資料，並以極高效率執行大量運算。若未能在適當的環節配置合適的晶片，AI將難以規模化發展。因此，產品發展藍圖、預算配置，以及市場進入策略等相關規劃，愈來愈常以矽晶片的選擇開始思考。

AI正在以前所未有的速度與廣度，成為推動半導體成長引擎，超越過往任何一波技術浪潮。其影響力正凌駕於雲端運算之上，並全面重塑產業優先順序，且差距仍在持續擴大。調查顯示，73%的受訪者將AI視為其最主要的營收驅動力，高於去年的67%。雲端運算、資料中心、網路相關領域的占比僅61%，較去年的63%進一步下滑。全球AI半導體市場預計將於2029年底達到4,385億美元，未來五年的年複合成長率（CAGR）高達25.9%。這一顯著成長反映出AI應用已擴展至終端裝置、車輛、資料中心及工業系統等多元場域，不再侷限於單一利基市場，而是技術堆疊的全面轉型。



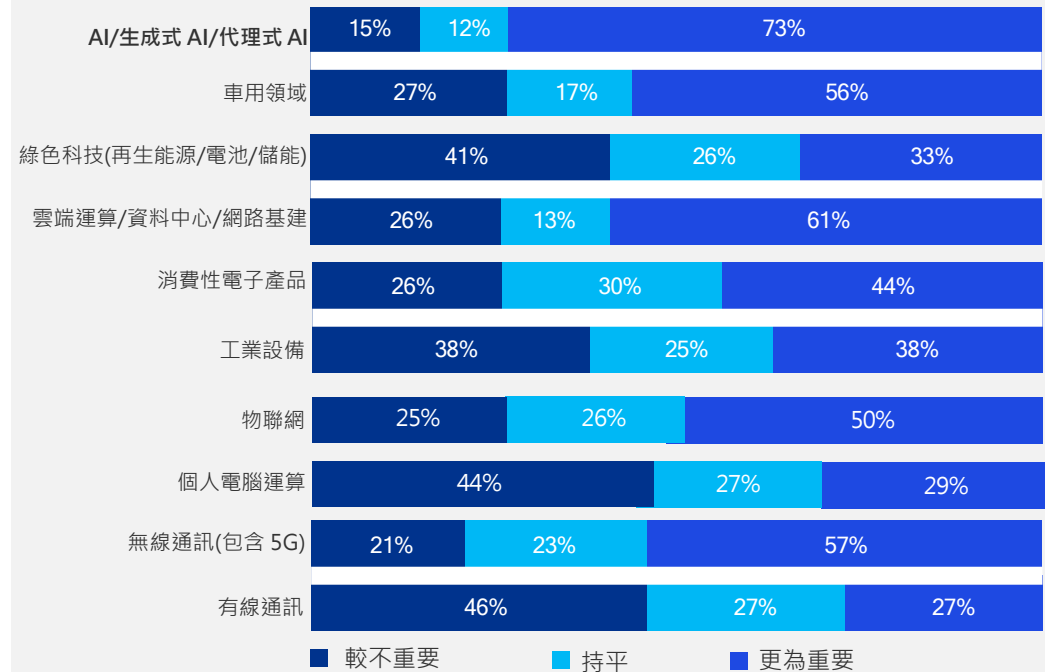
將AI視為  
最主要的營收驅動力

### 核心關鍵

人工智慧並非僅是附加在產品上的另一項功能，而是主導營收成長來源的關鍵力量。隨著AI在整個技術堆疊中帶動需求，下一個重要的策略性課題在於：供應鏈是否足以因應此成長動能。

### 圖1. 營收成長因素

相較於本年度，請問您預期貴公司下一年度的半導體相關資本支出（設備與軟體）的展望為何？



圖表資料：KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025年第四季。  
採四捨五入計算方式，百分比總和有可能不等於100%。



## 關鍵發現 2

# 記憶體成長機會躍升與微處理器並列

在歷屆半導體調查中，本次報告首度出現此結果，記憶體解決方案以67%躍居成長動能首位，相較於去年的49%大幅躍升，並進一步縮小多年來與微處理器之間的差距。

記憶體需求的持續成長，特別是高頻寬記憶體(HBM)，與AI工作項目逐步提升的運算需求有直接關聯。AI應用需要更高速且有效率的運算能力，進而推動對大容量儲存與先進記憶體解決方案的需求。因此，隨著AI採用程度不斷提升，市場對於具備高容量與高頻寬特性的記憶體解決方案之需求亦同步攀升。

同時，包括Amazon、Google Cloud 與 Microsoft Azure 在內的超大型雲端服務供應商(hyperscalers)，正加速對HBM的投資來支撐AI工作負載需求，並逐步採取已高度商品化的動態隨機存取記憶體(DRAM)以外的解決方案。事實上，部分DRAM製造商已開始調整產線，轉而生產HBM晶片，以掌握快速成長的市場先機。也因此，DRAM的供給開始日益趨緩。此一策略轉向，顯示半導體產業價值鏈中整體競爭態勢正出現結構性的重塑。

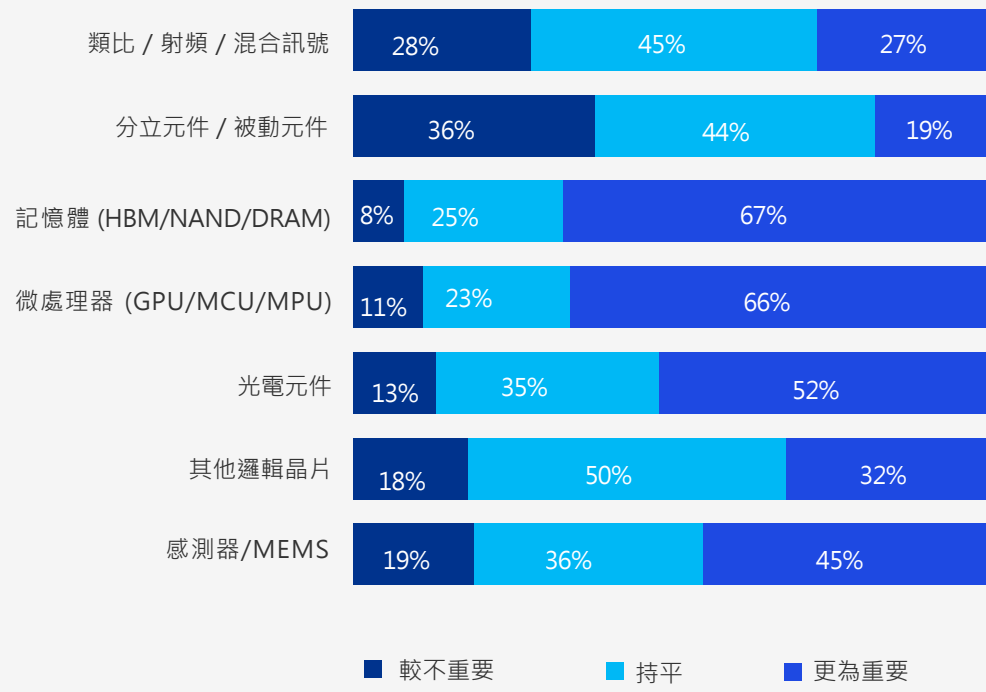


### 核心關鍵

AI並非僅是附加於既有產品之上的另一項功能，而是主導營收成長來源的關鍵力量。隨著AI在整個技術堆疊中帶動需求，下一個重要的策略性課題在於：供應鏈是否足以因應此成長動能。

### 圖2. 營收成長契機

請就未來 12 個月半導體產業的成長機會，為下列各項目進行評估。



圖表資料：KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025年第四季。採四捨五入計算方式，百分比總和有可能不等於100%。



### 關鍵發現 3

## 供應鏈已成為最優先的關注焦點

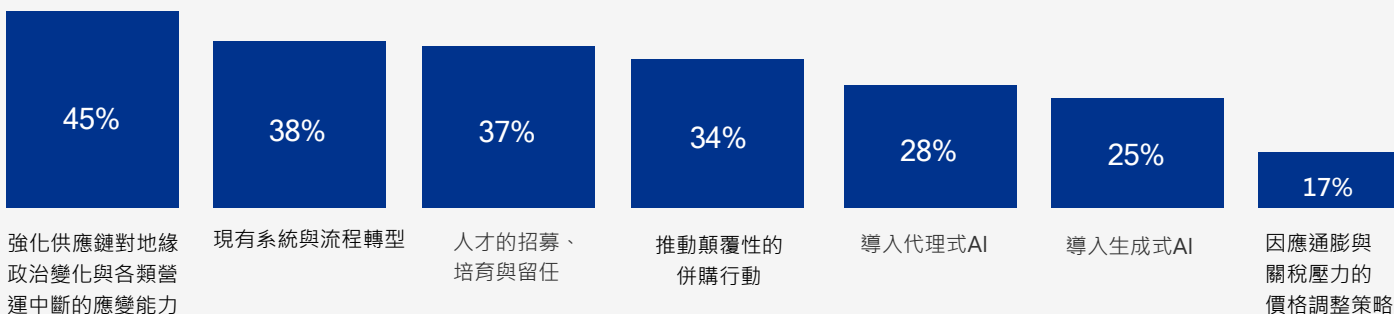
近三年來，供應鏈首次成為企業優先調查的核心議題。此一轉變反映出企業所面臨的真實經營挑戰，包括 COVID-19 所暴露的供應鏈脆弱環節、與中國大陸及台灣相關的新興瓶頸，以及稀土礦物等關鍵資源取得管道日益收窄等問題。

### 供應鏈的新關鍵在於速度與彈性

45%的受訪者表示將提升供應鏈快速調整與因應變化的能力為最優先事項，取代了去年度對人才議題的關注。然而，地緣政治不確定性及其他中斷風險仍然是關鍵隱憂。展望未來三年，有37%的受訪者認為半導體產業面臨的挑戰中，此一議題排名第三重要。

圖3. 首要優先策略

除了企業成長外，未來三年公司最關鍵的三項策略優先事項為何？



圖表資料：KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025 年第四季。

供應鏈為策略  
優先項目

#1



## 能源供應是否成為產業瓶頸

隨著AI驅動的需求激增，供給面因此出現一個關鍵問題：產業本身及其大型雲端服務(hyperscaler)客戶，是否能取得足夠的能源以維持這波成長？

以製造端為例，有34%的受訪者擔心，未來三年其製造設施的電力供應是否充足。而資料中心的疑慮更為嚴峻，58%的受訪者擔心，大型雲端服務業者在擴建AI就緒基礎設施時，可能難以取得足夠的能源供應。

記憶體與微處理器的整合趨勢，反映產業正邁入一個由底層技術架構選擇主導競爭優勢的新階段。同時，能源限制正逐步浮現為關鍵變數，其可能帶來的影響，與供應鏈波動所造成的結構性衝擊不相上下。潛在的解決方案，或許來自於原驅動的核心技術—透過導入AI優化能源使用效率，資料中心可在部分增加電力消耗的前提下，擴展運算需求並持續維持成長。



## 公私部門協作的利弊

調查發現，在敏捷性與政府夥伴關係之間的互動有著一項策略上的悖論，若要在科技最前沿保持競爭力，公共資金與共同投資似乎已無法避免；然而，政府合作常伴隨對市場行為的相關規範，可能進一步限制企業在供應採購與市場進入方面的靈活性。

48%的受訪者對於政府在半導體產業的補貼影響表示憂慮，且多數受訪者(54%)認為若政府成為投資者，將限制企業的市場敏捷度與創新能力。

即使如此，受訪者同時也認為政府在私部門中所扮演某些「不可避免且具轉型意義的角色」；同樣有54%企業認為，若要興建全球最先進的晶圓製造廠，部分政府資金挹注或政府持股如今已成為必要條件。

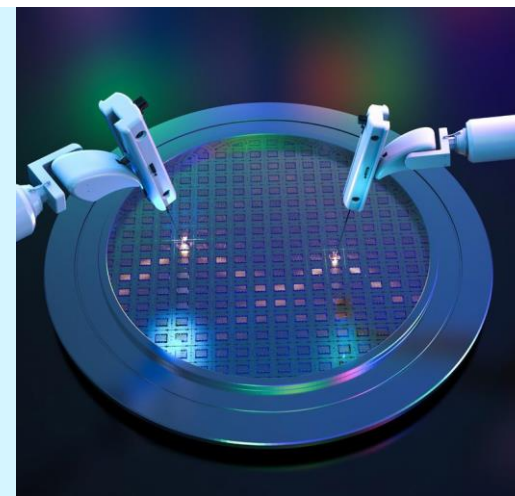
數據顯示：半導體產業的網絡極為複雜，仰賴全球化的專業供應商與製造據點——尤其集中台灣等地；與此同時，各國政府正積極介入晶片的製造方式與生產地點。該策略同時帶來機會，也伴隨相關風險。

調查顯示，受訪者透過將生產與採購分散至更多地點來強化韌性。其目標相當明確：避免聚焦單一地點，確保即使某一地區受到阻礙，產品仍能持續供應。為此，超過半數的受訪者(54%)計劃在未來12個月內提升其供應鏈地點的多元性。同時，受訪者指出，企業已開始運用生成式AI (GenAI) 以提升前瞻洞察能力並加速決策流程，其中有36%認為未來十二個月內GenAI的導入重點將聚焦於採購與供應鏈管理，透過預測分析與自動化工具提早辨識供應短缺、優化庫存配置，並及早確保產能安排。從區域層面觀察，各國採取的策略亦呈現差異，美國與歐洲企業正著力於推動在地製造與產業回流，例如透過《CHIPS 法案》與《歐盟晶片法案》強化本土供應能力；相較之下，亞洲業者則更著重於在區域網絡中建立備援機制，以提升整體區域韌性。

### 核心關鍵

產業正由過去線性的供應模式，轉型為具備高度韌性與多重備援的供應安全體系。然而，在半導體景氣循環中，如何在追求前瞻技術布局的同時，維持對供應網絡的充分掌控，將成為企業管理層面臨的關鍵結構性挑戰之一。

率先完成轉型的企業，將有能力將市場波動內化為競爭優勢，不僅確保當前的穩定性，更為中長期成長奠定堅實基礎。隨著供應鏈架構持續朝向更高韌性與彈性的設計，企業領導者接下來的核心課題，在於確保組織與人才能力能同步升級，以加速這場由 AI 驅動的產業轉型。





## 關鍵發現 4

# AI提升人力效能而非精簡組織

人才短缺問題持續存在，半導體產業領導者一邊積極推動招募，同時更加倚重人工智慧來提升生產力。隨著人才與智慧系統開始以全新的方式協作，整體產業對「競爭優勢」的定義正發生轉變。半導體的角色不在只是用於運算的範疇。未來十年中，能夠全面重塑其產品、營運模式與市場進入策略，並且關注AI驅動的企業，將能在競爭中脫穎而出。

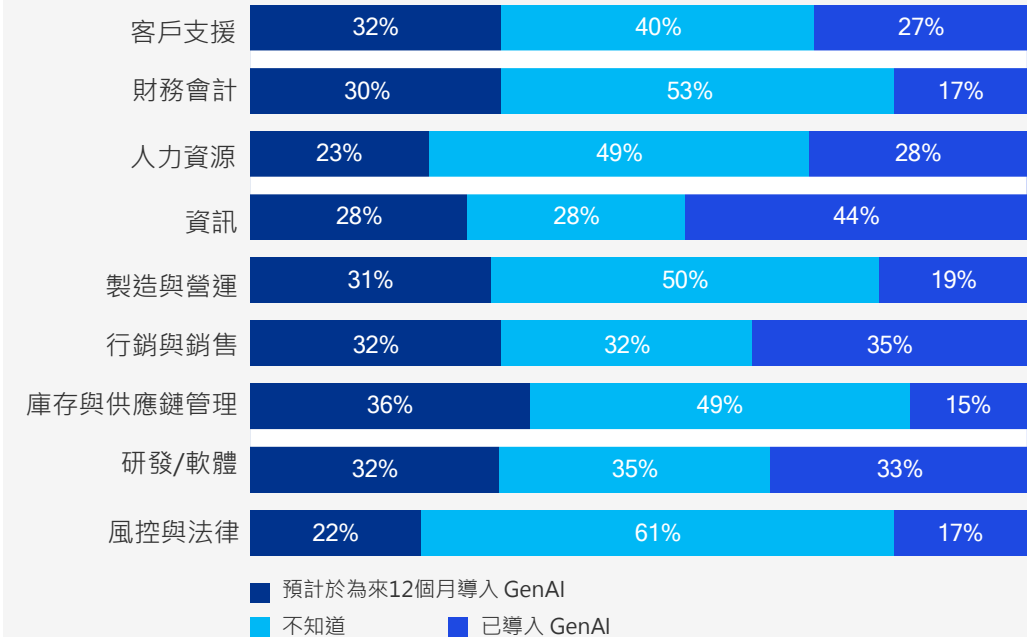
人工智慧已經逐步重塑工作模式。目前在企業內部，AI的高度應用主要集中於資訊與研發單位，協助加速決策流程、優化作業程序。其次為採購與供應鏈部門，管理階層看好AI能夠協助需求預測、簡化物流流程並降低營運風險。行銷與銷售團隊同樣開始運用AI，以實現更個人化的客戶溝通並預測客戶需求。更進一步來看，代理型 AI 工具也正迅速在這些領域中落地並擴大應用。

人工智慧影響力正持續擴大且不斷演進，應用範圍涵蓋資訊與研發(R&D)，並延伸至供應鏈管理與行銷等領域。目前，半導體企業已在 IT (44%) 與研發單位中導入生成式AI，透過AI驅動的自動化，加速決策流程、提升製程與作業最佳化水準，提升整體工作流程效率。

採購與供應鏈管理是近期導入生成式AI的首要領域(36%)。企業預期，AI能強化需求預測的預測分析能力、優化物流運作，並有效降低供應鏈風險。此外，AI也正被廣泛應用於提升客戶互動體驗、提供個人化行銷策略，以及改善銷售預測準確度，其中兩個領域的導入比例皆為 30%。

### 圖4. AI 人工智慧

請問貴公司已在哪些職能領域中導入，或預計於未來 12 個月內導入生成式人工智慧 (GenAI)？



圖表資料：KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025 年第四季。  
採四捨五入計算方式，百分比總和有可能不等於100%。

# 人才招募與留任為關鍵優先事項

人工智慧並未取代對人才的需求。受訪者指出，人才議題僅次於關稅，是他們面臨的最大挑戰之一；而培育並留任這些人才，也是重要的優先策略之一。

圖5. 產業面臨的挑戰

請問您認為未來三年全球半導體產業將面臨的最大問題是什麼？(最多三項)

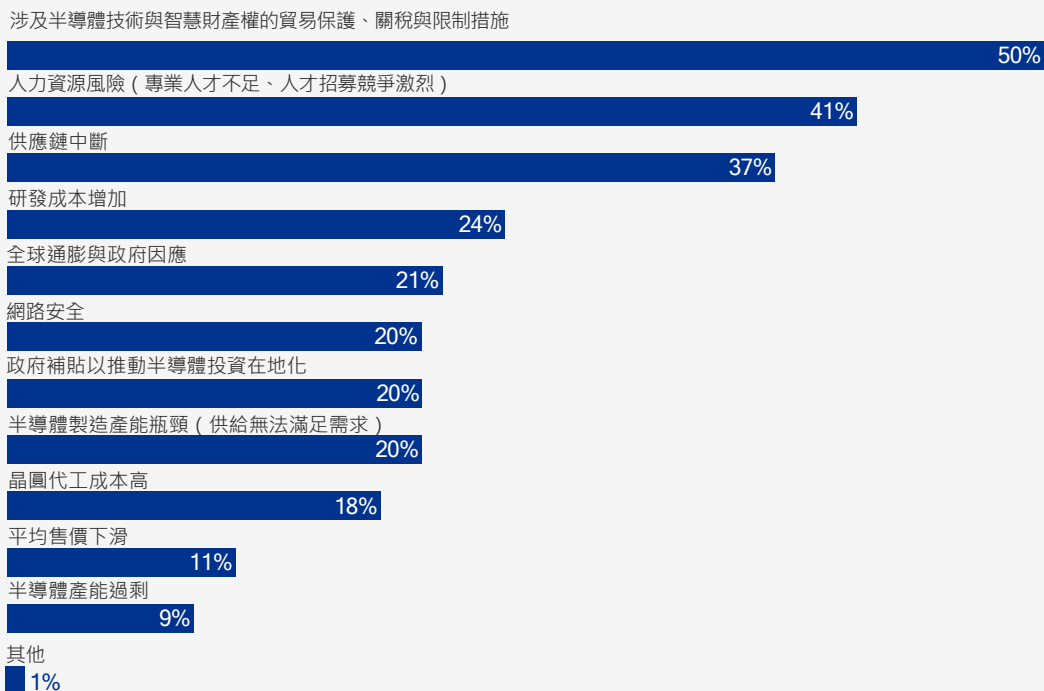
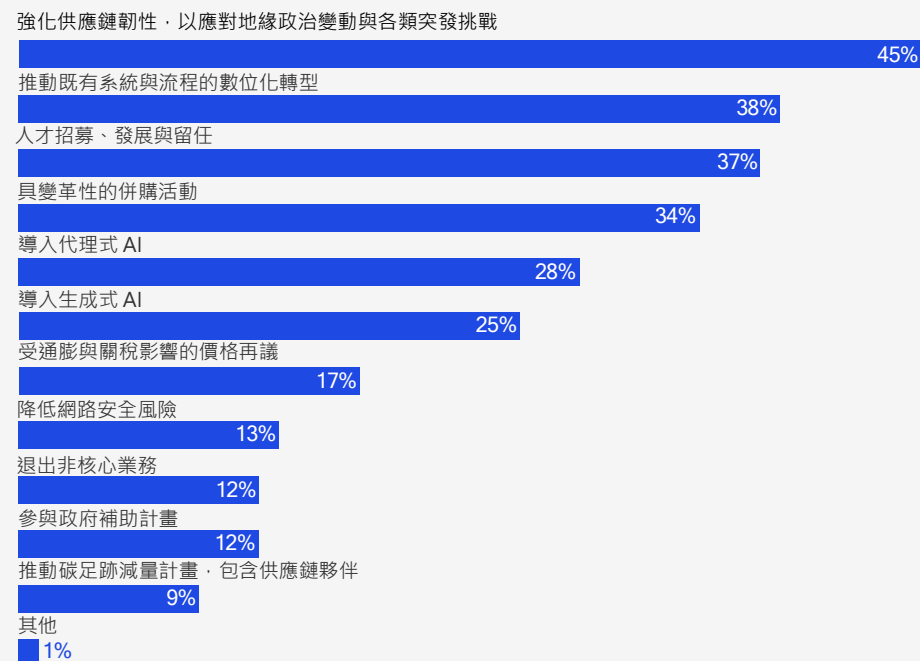


圖6. 策略優先事項

除成長目標外，貴公司在未來三年的前三大策略重點為何？(最多三項)



圖表資料：KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025 年第四季。採四捨五入計算方式，百分比總和有可能不等於100%。

為因應需求持續成長，65%的受訪者預期將在未來一年擴大人力規模。然而，他們也清楚認知 AI 所扮演的角色。善用科技、人工智慧與自動化以提升人力生產力，是企業為成長目標所採取的首要行動（54%），其次則是員工訓練與技能升級計畫（46%）。隨著人力規模擴張與 AI 的應用，企業正逐步形成一種全新的人才模式，專業將由 AI 之應用加以放大與強化。這項轉變將影響企業在整個半導體價值鏈中，如何進行人才招聘、培訓以及組織設計。在市場動能持續累積之下，整個產業正全速前進。

## 圖7. 產業問題及策略優先

為達成公司成長目標，請問貴公司採取那些做法確保並強化所需的人才能力？

透過科技、AI 與自動化，全面提升員工生產力



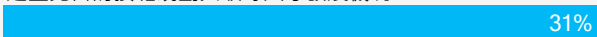
持續投入員工培訓、技能再提升 (Upskilling) 及人才發展方案



優化員工留才與參與度管理策略



建置完善的接班規劃與領導人才發展機制



招募具備專業與關鍵技能的新人才



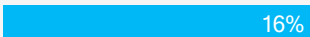
打造具吸引力的薪酬獎勵方案與彈性工作模式



與教育機構或產業組織合作，建立人才管道



擴大全球人才搜尋與招募力度



其他



圖表資料：KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025年第四季。  
採四捨五入計算方式，百分比總和有可能不等於100%。





## 關鍵發現 5

# 儘管風險持續浮現，市場樂觀度仍持續升溫

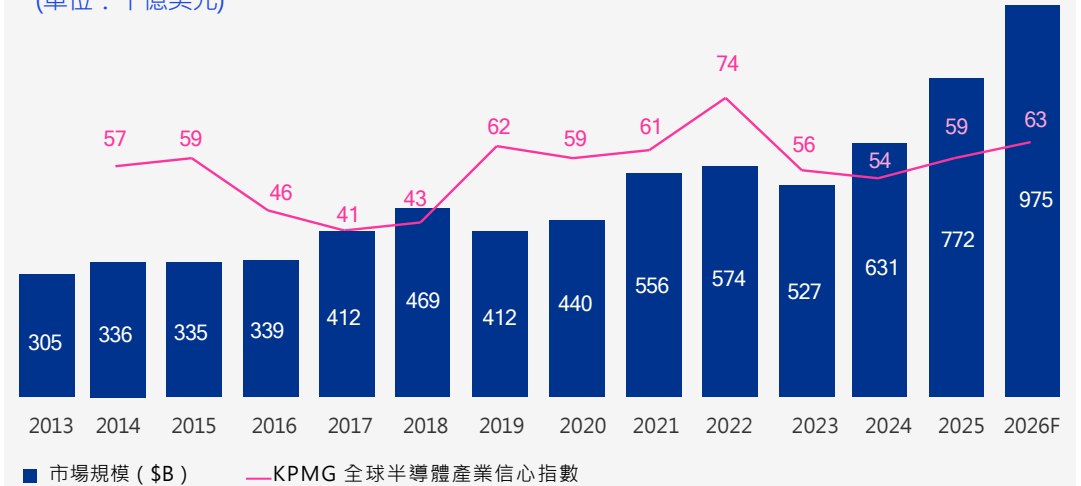
調查顯示，半導體領導者對未來一年的看法，呈現一致的主軸，儘管地緣政治與資源風險持續存在，整體信心仍在上升。其中，信心指數達到63(去年為59)，創下該調查21年來第三高水準。即使市場挑戰持續，仍呈現強勁的樂觀訊號。整體市場的成长預測進一步維持這股樂觀情緒。全球半導體市場規模預計將於2026年達到1兆美元。其中，邏輯晶片與記憶體領域的成长動能最為強勁，主要受惠於人工智慧與資料中心需求的持續擴張。自2022年底以來，全球半導體銷售額已大幅成長約 50%，進一步強化市場共識，屬於結構性、廣泛性的上行循環，而非短暫的反彈趨勢。

企業領導者已開始依據這一項展望採取行動。超過半數的受訪者(54%)預期其公司營收將成長 11% 以上。未來12 個月內的主要策略方向包括：擴大招募人力、升級資訊系統，以及推動併購，皆明顯展現以成長為導向的布局思維。資本投資計畫亦呈現相同趨勢，66%的受訪者預期未來一年資本支出將增加，相較去年 (63%) 進一步上升。然而，即使企業正積極布局，仍有 58% 的受訪者預期，未來 12 個月內客戶需求的不確定性將對營運產生重大影響。而在供應面上，領導者也正密切關注稀土、化學品與能源等關鍵資源所面臨的地緣政治與其他壓力挑戰，以及全球性事件可能引發的供應中斷風險。

該如何在需求前景仍不確定的情況下，同步推動具前瞻性的成長策略布局？答案主要取決於「時間點」。許多晶片製造商目前手中握有大量且穩健的訂單積壓，但產能擴張速度跟不上中期市場需求；這種供不應求的狀況，有助於支撐較高的利潤水準。然而，季度之間的需求仍可能呈現波動，產品組合同樣可能快速產生變化。

圖8. 全球半導體市場及產業信心指數

(單位：十億美元)



圖表資料：WSTS, KPMG 與 GSA 全球半導體調查，2025 年第四季。

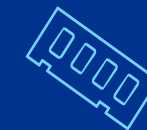
在市場普遍看好下一個週期有望翻倍成長的同時，企業高層可能正反思自己投資組合的未來走向。企業可透過擴充產能、強化人才布局與提升整體能力來放大成長潛力；同時，也需要藉由更精準的需求洞察、多元化的供應來源，以及審慎且有紀律的資本配置來降低下行風險。有助於企業將當前的市場樂觀轉化為長期、可持續的獲利成長。

# 重點建議

人工智慧不再只是半導體產業的新興機會，而是成為該產業最關鍵的營收驅動力。此轉變使領導者必須迅速以AI為核心，重新整合產品布局、營運模式與資本策略，同時針對各區域市場動態，打造相應的發展路徑。

## 1 記憶體成長機會躍升與微處理器並駕齊驅

隨著記憶體產品躍升為主要成長動能，其發展也在晶圓廠及超大規模資料中心所需的能源供應限制下，演變為一項關鍵的策略挑戰。能夠及早行動、同步整合產品布局、鎖定目標客戶與能源策略的領導者，將最有機會建立長期成長優勢。



## 2 在地緣政治動盪中，打造韌性供應鏈

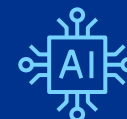
在地緣政治壓力、關稅、貿易限制，以及能源與資源可得性等因素的衝擊下，供應鏈的敏捷性正面臨重大威脅。領導者必須採取能夠降低脆弱性、提升回應速度，同時維持創新能力的策略。當前趨勢已十分明確：敏捷性已不再是可有可無的選項，而是維持競爭力的基本門檻。



# 重點建議

## 3 運用AI強化人才韌性與提升勞動生產力

生成式 AI 與代理型 AI 正快速重塑半導體產業的各項職能，從 IT 與研發延伸至供應鏈、行銷與銷售，不僅精簡工作流程、優化決策品質，也加速創新週期。面對以 AI 為核心的時代，企業高層必須在人才與科技兩個層面之間取得平衡，打造具韌性的工作力策略，才能在競爭中脫穎而出。



## 4 因應經濟與地緣政治風險，維持策略性成長

半導體產業整體情緒依然高度樂觀，反映在持續攀升的信心指數與創新高的資本支出計畫上；然而，客戶需求的波動性與地緣政治風險，亦為前景增添不確定性。產業領導者必須在積極擴張與嚴謹的風險管理之間取得平衡，避免過度投資與資源失衡，同時在這一波高成長週期中建立並鞏固競爭優勢。



A glowing blue microchip is centered on a complex circuit board background. The chip is a square with a dark center and a lighter blue border. The circuit board is filled with intricate patterns of lines and dots, all illuminated with a vibrant blue light. The overall aesthetic is high-tech and futuristic.

# 關於2026全球半導體產業大調查

KPMG 連續第21年發布《全球半導體產業大調查》與全球半導體聯盟（GSA）合作調查報告；本次報告在2025年第四季訪問全球151位半導體產業高階主管，其中，過半數的受訪者來自年營收10億美元以上的企業，藉此調查了解產業機會與挑戰的全面觀點。



## Contact us



**鄭安志 Archie Cheng**

科技、媒體與電信產業主持會計師

**T** (02) 8101 6666 #07719

**E** [archiecheng@kpmg.com.tw](mailto:archiecheng@kpmg.com.tw)



**李威陞 Carson Lee**

科技、媒體與電信產業主持人

**T** (02) 8101 6666 #18227

**E** [carsonlee@kpmg.com.tw](mailto:carsonlee@kpmg.com.tw)



**吳趙仁 Marshal Wu**

科技、媒體與電信產業協同主持會計師

**T** (02) 8101 6666 #06281

**E** [marshalwu@kpmg.com.tw](mailto:marshalwu@kpmg.com.tw)



**張維欣 Waylon Chang**

科技、媒體與電信產業協同主持會計師

**T** (02) 8101 6666 #10309

**E** [waylonchang@kpmg.com.tw](mailto:waylonchang@kpmg.com.tw)



[kpmg.com/tw](https://kpmg.com/tw)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

© 2026 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

**Document Classification: KPMG Public**